



Deutsche IMAPS Konferenz

10./11. Oktober 2006, München

Call for Papers

Wie bereits Tradition findet die Deutsche IMAPS-Konferenz 2006 an der Technischen Universität in München statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie zu einem der folgenden Themen der *Mikroelektronik*, des *Packaging* bzw. der *Aufbau- und Verbindungstechnik* einen Vortrag von ca. 20 Minuten Dauer halten:

- *Materialien und Technologien*
(Dickschicht, Dünnschicht, LTCC, Advanced PCBs, MCMs, Flip Chip, CSP, COB, SMT)
- *Design und Modellierung*
(Fertigungsgerechtes Design, thermische/mechanische/elektrische Simulation, CAD)
- *Fertigung und Prozesse*
(Large Panel Prozessierung, HDI-Prozesse)
- *Anwendungen*
(HF/Mikrowellenschaltungen, Power Packaging, Kommunikationstechnik, Automobilelektronik, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt)
- *Qualität und Zuverlässigkeit*
(Test und Inspektion, Package Zuverlässigkeit, Qualitätsstandards)
- *Umweltaspekte*
(Bleifreie Produkte, Recycling, Umweltverträgliche Materialien)

Bitte senden Sie Ihren Abstract (ca. 200 Wörter) bis zum **26. Mai 2006** an:

Dr.-Ing. Gisela Dittmar, Ingenieurbüro Elektroniktechnologie Dittmar, Egerlandstr. 88, D-73431 Aalen,
Tel. 07361/931129, Fax 07361/943004, gisela.dittmar@imaps.de

Es wird wieder ein BEST PAPER AWARD vergeben !

☞ *Nutzen Sie bitte auch die Möglichkeit der Online-Anmeldung unter: <http://www.imaps.de/>* ☞

4th European Microelectronics and Packaging Symposium EMPS

Terme Catez, Slovenia, 21./24. Mai 2006

Das 4th European Microelectronics and Packaging Symposium findet in wenigen Tagen statt. Wir wollen hier nochmals an diese Veranstaltung erinnern.

Inzwischen liegt auch das vorläufige Programm vor:

Sonntag, 21. Mai 2006

16.00-18.00 Registration

19.00-22.00 Fusion Party (Workshop+Symposium)

Montag, 22. Mai 2006

08.00-18.00 Registration

11.00-18.00 Table-top Exhibition

09.00-11.00 Opening and Plenary Session

11.10-11.40 Coffee Break

11.40-13.00 Session 1

Materials and Processes

Session 2

Embedded Active Components

13.00-15.00 Lunch Break

- 15.00-16.20 Session 3
Integrated Passives
Session 4
Advanced Packaging
- 16.20-16.50 Coffee Break
- 16.50-18.10 Session 5
Advances in LTCC
Session 6
Microelectronic Applications and Trends
- 19.00-22.00 Reception

Dienstag, 23. Mai 2006

- 08.00-18.00 Registration
- 11.00-18.00 Table-top Exhibition
- 08.30-09.50 Session 7
Thick & Thin Film
Session 8
Semiconductor Structures and Circuits



Terme Catez ist landschaftlich reizvoll gelegen und bietet auch gute Freizeitmöglichkeiten

- 09.50-10.20 Coffee Break
- 10.20-11.40 Session 9
Interconnection
Session 10
Quality & Test Technologies
- 11.40-11.45 Short Break
- 11.45-13.00 Special Session
- 13.00-15.00 Lunch Break
- 15.00-16.20 Poster Session
- 16.40-20.10 Excursion
- 20.30-22.30 Conference Dinner

Mittwoch, 24. Mai 2006

- 08.00-12.00 Registration
- 09.00-12.00 Table-top Exhibition
- 08.30-09.50 Session 11
Thermal Management
Session 12
Lead free & Environmental I
- 09.50-10.20 Coffee Break
- 10.20-11.40 Session 13
Design & Simulation
Session 14
Lead free & Environmental II
- 11.40-12.00 Closing Session

Auf der Webseite www.emaps2006.com finden Sie alle Informationen zu Programm, Tagungsort, Registrierung etc.

Im Zusammenhang mit dem Symposium finden auch eine begleitende Ausstellung sowie ein Workshop zu *ferroelektrischer Dünn- und Dickschichtverarbeitung und deren Anwendung in MEMS* statt.

Professor Heiko Thust im Ruhestand



Professor Heiko Thust beendete am 30. März 2006 nach Erreichen der Altersgrenze seine Tätigkeit als Hochschullehrer an der *TU Ilmenau* und ist nunmehr im Ruhestand.

Heiko Thust studierte von 1959 bis 1965 an der damaligen *Hochschule für Elektrotechnik* in Ilmenau Mikrowellentechnik und Wellenausbreitung. Anschließend war er als Entwicklungsingenieur bei *RAFENA* in Radeberg tätig. Er kehrte danach als wissenschaftlicher Assistent nach Ilmenau zurück, wo er 1975 seine Dissertation zum Thema „Synchronisation

und Rauschverhalten von verkoppelten Oszillatoren im Dauerstrichbetrieb“ erfolgreich verteidigte. Im selben Jahr erfolgte dann der Wechsel zum Wissenschaftsbereich *Konstruktion und Technologie elektronischer Funktionsblöcke*. Obwohl dieser Wechsel nicht unbedingt auf seinen Wunsch hin erfolgte (die seinerzeit Verantwortlichen wollten nur „politisch besonders zuverlässige Mitarbeiter“ im Gigahertzbereich forschen lassen), baute er mit großem Engagement eine Arbeitsgruppe *Dickschicht-Hybridtechnologie* auf. Diese widmete sich alsbald der Untersuchung von Dickschichtstrukturen, u.a. im Frequenzbereich über 1000 MHz. 1979 erfolgte die Ernennung zum Wissenschaftlichen Oberassistenten und 1985 die Habilitation (seinerzeit „Promotion B“) zum Thema „Berechnung und Entwurf von Dickschichtelementen“.

Ein weiterer Karrieresprung war dann erst nach der deutschen Wiedervereinigung möglich. Im Jahre 1992 wurde

Heiko Thust zum Universitätsprofessor für das Fachgebiet *Mikroperipherik* berufen. 1994 wurde er als Nachfolger von *Frau Prof. Schipanski* Dekan der Fakultät *Elektrotechnik* der *TU Ilmenau*. Dieses Amt hatte er bis 1995 inne.

Die ersten Jahre nach Gründung des Fachgebiets waren dem systematischen Ausbau der technologischen Ausstattungen gewidmet, so dass bald eine auf dem aktuellen Stand befindliche komplette Dickschichthybridstrecke zur Verfügung stand. Seit Anfang der 90er Jahre wurde an der *TU Ilmenau* der Bau eines Technologiegebäudes geplant. Dazu schlossen sich fakultätsübergreifend mehrere Fachgebiete zusammen. Das Fachgebiet *Mikroperipherik* gehörte von Anfang an dazu. *Prof. Thust* war während der gesamten Planungsphase, die sich dann doch bis zum Ende des alten Jahrtausends hinzog, sehr stark engagiert. Von 1999 bis 2001 übernahm er die Funktion des Direktors der nunmehr *Zentrum für Mikro- und Nanotechnologien (ZMN)* genannten Einrichtung. Auch während der gesamten Gründungs- und Ausbauphase des ZMN wurde die technologische Basis des Fachgebiets ständig erweitert, da sich das Arbeitsgebiet zunehmend auf keramische Folientechnologien (LTCC) verlagerte.

Bereits kurz nach der Währungsunion 1990 war *Heiko Thust* der deutschen ISHM beigetreten. In den folgenden Jahren leisteten er und sein Fachgebiet hier wesentliche Beiträge zu den wissenschaftlichen Veranstaltungen. Darüber hinaus war er auch auf zahlreichen internationalen Veranstaltungen von ISHM bzw. IMAPS aktiv und arbeitete auch lange im Programmkomitee (subcommittee *microwaves*) der amerikanischen Muttergesellschaft mit.

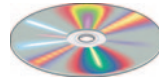
Während seiner Zeit als Hochschullehrer nahm *Prof. Thust* auch außerhalb der *TU Ilmenau* zahlreiche Aufgaben wahr. So war er über mehr als 10 Jahre Mitglied der Auswahlkommission Osteuropa des *DAAD* und beteiligte sich an der Evaluation deutschsprachiger Studiengänge in Osteuropa. Im Konsortium *PROKOPE*, welches sich der Förderung der deutsch-französischen Forschungszusammenarbeit widmet, hat er ebenfalls lange Zeit aktiv mitgewirkt.

Prof. Thust wird sich nicht vollständig aus der fachlichen Arbeit zurückziehen. Er betreut nach wie vor Promovenden und ist auch noch in Projektarbeiten eingebunden. Dem Vorstand von *IMAPS Deutschland* hat er versprochen, besonders bei der Mitgliederwerbung und bei der Organisation von Veranstaltungen beratend mitzuwirken. Wir werden ihm also auch zukünftig bei den *IMAPS*-Veranstaltungen begegnen.

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings des *Deutschen IMAPS-Seminars 2006*, das am 9. Februar 2006 in Göppingen zum Thema *Muss*

jeder Sensor smart sein? stattfand, können auf CD zum Preis von



€ 55,-

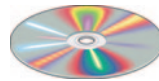
und als Papierausdruck zum Preis von



€ 110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings der *Herbsttagung 2005*, die am 10. und 11. Oktober 2005 in München durchgeführt wurde, sind noch als CD zum Preis von



€ 55,-

erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Prof. Dr. Wolfgang Radlik, c/o FH Rosenheim, Hochschulstraße 1, D-83024 Rosenheim, Fax 08031/805-603, wolfgang.radlik@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die Webseiten von IMAPS Deutschland im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.* Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von IMAPS erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

Kontakte und Adressen des IMAPS-Vorstandes

Dr.-Ing. Jens Müller

1. Vorsitzender

c/o ZiK MacroNano

ZMN – Außenstelle Haus M

Am Helmholtzring 1

98693 Ilmenau

Fon: 03677/69-3381

Fax: 03677/69-3379

e-mail: jens.mueller@imaps.de

Dr.-Ing. Gisela Dittmar
2. Vorsitzende
c/o Ingenieurbüro Elektroniktechnologie
Egerlandstraße 88
D-73431 Aalen
Fon: 07361/931129
Fax: 07361/943004
e-mail: gisela.dittmar@imaps.de

Prof. Dr. Wolfgang Radlik
Schatzmeister
c/o FH Rosenheim
Hochschulstraße 1
D-83024 Rosenheim
Fon: 08031/805-629
Fax: 08031/805-603
e-mail: wolfgang.radlik@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Matthias Fischer
Schriftführer
c/o FH Schmalkalden
FB Elektrotechnik
D-98574 Schmalkalden
Fon: 03683/688-5116
Fax: 03683/688-5499
e-mail: matthias.fischer@imaps.de

Dipl.-Phys. Rolf Aschenbrenner
Öffentlichkeitsarbeit
c/o Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit
und Mikrointegration
Chip Interconnection Technologies
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
Fon: 030/46403-164
Fax: 030/46403-161
e-mail: rolf.aschenbrenner@imaps.de

Dipl.-Ing. Thomas Bartnitzek
Öffentlichkeitsarbeit
c/o VIA electronic GmbH
Robert-Friese Straße 3
D-07629 Hermsdorf
Fon: 036601/81-529
Fax: 036601/81-530
e-mail: thomas.bartnitzek@imaps.de

Dipl.-Ing. Paradiso Coskina
Öffentlichkeitsarbeit
c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Steinplatz 1
D-10623 Berlin
Fon: 030/310078-242
Fax: 030/310078-256
e-mail: paradiso.coskina@imaps.de

Dr.-Ing. Karl-Heinz Drüe
Öffentlichkeitsarbeit
c/o TU Ilmenau
Fakultät EI
FG Mikroperipherik
PF 100565
D-98684 Ilmenau
Fon: 03677/69-3429
Fax: 03677/69-3350
e-mail: karl-heinz.drue@imaps.de

Ernst Eggelaar
Öffentlichkeitsarbeit
c/o Microtronic Microelectronic Vertriebs GmbH
Klein Grötzing
D-84494 Neumarkt-St. Veit
Fon: 08722/9620-0
Fax: 08722/9620-30
e-mail: ernst.eggelaar@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Heinz Osterwinter
Öffentlichkeitsarbeit
c/o FHTE Standort Göppingen
Robert-Bosch-Str. 1
D-73037 Göppingen
Fon: 07161/679-157
Fax: 07161/679-233
e-mail: heinz.osterwinter@imaps.de

Dr. Martin Oppermann
Öffentlichkeitsarbeit
EADS Deutschland GmbH
Microwave Factory / Defence Electronics
Woerthstr. 85
D-89077 Ulm
Fon: 0731/392-3879
Fax: 0731/392-3362
e-mail: martin.oppermann@imaps.de